

证券代码：001270

证券简称：铖昌科技

## 浙江铖昌科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：20241029

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与单位	百年保险资管、平安基金、鹏华基金、华泰柏瑞、银河基金、诺安基金、财通自营、德邦基金、景和资产、兴全基金、兴全基金、国盛证券、兴业证券、国联证券、中庚基金、中大投资、天戈投资、中亿投资、正圆投资、钛禾资本、汐泰投资。
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监：张宏伟 副总经理、董事会秘书：赵小婷 证券事务代表：朱峻瑶
时间	2024年10月29日
地点	会议室
形式	现场调研
交流内容及具体问答记录	<p>一、公司基本情况简介</p> <p>2024年三季度经营情况介绍：</p> <p>因受下游用户需求计划的影响，2024上半年公司交付项目产品进度较慢，前三季度营收规模也受到影响波动较大。公司2024年前三季度实现营业收入10,043.24万元，较上年同期下降7,041.93万元，同比下降41.22%。目前下游用户需求已处于恢复状态，价格体系也在逐步趋于稳定。公司积极备货及交付，已在争取加快进度完成各领域项目</p>

的生产交付。公司 2024 年第三季度实现营业收入 2,861.33 万元，较上年同期增加 2,303.65 万元，同比增加 413.08%。因受营业收入规模较小、股权激励股份支付费用计提及研发投入增加的影响，2024 年第三季度实现净利润-724.96 万元，但较上年同期-1,222.98 万元实现增长 40.72%。

根据客户生产计划要求，公司 2024 年生产交付任务主要集中于下半年，公司管理层以及整个团队一方面将全力推进各项目交付的进度，另外一方面公司应收账款金额较高，主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，安全性相对较高，公司在积极持续与客户充分沟通回款，以减少计提对净利润的影响。2024 年前三季度营收及净利润虽短期承压，公司已在积极跟进和响应下游的项目进展及配套需求，促进公司经营目标的实现。

## 二、问答环节

### 1、请介绍下公司前三季度交付项目的情况？

答：前三季度公司产品主要批量交付于星载、机载、地面相控阵雷达及卫星通信等领域。公司在星载领域具有深厚的技术积累和项目配套优势，一直不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量，参与的多个研制项目陆续进入量产阶段。机载领域产品主要以机载通信应用的相控阵天线 T/R 芯片为主，已与客户形成深度的合作配套关系，有效的推进了项目进度，机载领域相控阵 T/R 芯片产品成为公司主要营收部分之一。地面领域产品受到下游客户需求影响较多，交付规模较上年有所下降，随着客户需求计划的恢复，项目已在逐步批产阶段。

公司将继续加大市场开发与新领域拓展力度，利用公司的技术和优势，不断拓展产品在各类装备中的应用。

### 2、报告期内公司计提的信用减值损失有所回转，请详

**细说明？**

答：因下游回款周期时间较长、应收账款的账龄有所增加，公司 2024 上半年计提的信用减值损失相对较高。公司应收账款主要来源于国家大型集团科研院所等优质客户，应收账款安全性相对较高。公司 2024 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失金额为 2,046.26 万元，三季度较上半年已转回 849.88 万元。公司将应收账款回款工作作为年度重点工作之一，积极持续与客户充分沟通回款。

**3、公司产品所处行业技术前瞻性如何？**

答：相控阵天线体制装备在频宽、信号处理和冗余设计上都比传统无源及机械扫描天线体制具有较大的优势，这使得基于相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向。

公司在相控阵 T/R 芯片领域深耕多年，是国内少数能够提供 T/R 芯片完整解决方案的企业之一，产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。公司将会继续加大研发投入，满足客户产品高频化、高集成度、轻量化、多功能化的技术需求，并布局行业性前瞻技术研究，保持公司产品先进性水平。

**4、公司在卫星通信领域布局较早，请问情况及进展如何？**

答：公司在星载领域具备核心技术创新优势，在行业中领先推出卫星通信相控阵 T/R 芯片全套解决方案，领先进入了主要客户核心供应商名录，卫星通信相控阵 T/R 芯片产品自 2022 年起批量生产并持续交付中。报告期内，公司与科研院所及相关优势企业合作关系紧密，持续进行卫星通信 T/R 芯片解决方案的迭代研制，为后续的计划做技术开发储备。

**5、公司近年来研发投入规模逐步增大，请问在哪些方向？**

答：公司注重自主创新及核心技术能力的提升，研发费用逐年提升。研发投入的布局上主要分为两个方面，一方面结合客户对芯片产品的功能和性能等需求，依托积累的技术与经验，承担多领域新装备研发需求，不断提升性能、保持产品的技术先进性及成本优势，为下游应用提供更全面、完整的产品解决方案。

另一方面公司坚持技术引领方向，重点把握市场发展趋势，在前瞻性技术应用领域进行布局。公司研发团队已完成 C、X、Ku、K、Ka、W 等波段以及超宽带多通道、多波束、低功耗、多功能模拟波束赋形系列化产品，并完成相配套的系列化射频前端套片开发，形成了覆盖多种应用场景完备的高集成度、低成本核心解决方案。公司将进一步提高产品的竞争力并为下游客户提升产品性能助力。

**6、请介绍一下公司产品技术特点？**

答：作为国内从事相控阵 T/R 芯片研制的主要企业，公司产品涵盖整个固态微波产品链，主要产品分为功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、收发前端芯片、幅相控制芯片和无源类芯片五类，具体产品包括 GaAs/GaN 功率放大器芯片、GaAs 低噪声放大器芯片、GaAs 收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等。

公司产品的工艺制程属于成熟制程范围，能够提供各典型频段的微波毫米波模拟相控阵系统芯片解决方案。通过高精度测试及模型修正、可靠性提升及试验验证等技术

	<p>手段，公司所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点。</p> <p><b>7、SIP封装、微系统封装的发展会对公司产品产生影响吗？</b></p> <p>答：公司主营产品相控阵 T/R 套片作为射频前端芯片，在相控阵体制的雷达、天线等装备中是核心元器件之一，具有重要作用。SIP、微系统等属于公司下游用户的一种封装形式。</p> <p><b>8、公司一直在拓展产品应用领域，今年在机载领域有所起量，进展情况如何？</b></p> <p>答：公司前期布局了各领域多个项目。自今年起机载领域项目进展可观，套片已经用户系统验证并已开始多个型号装备中陆续进入量产阶段，下游用户有着持续量产需求，机载领域 T/R 芯片产品已成为公司主要营收部分之一。目前公司已在积极备货积极生产交付中。公司将继续拓展下游应用领域，扩大产品在多领域的市场份额。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>